

科技部 107 年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」

業界合作意願書

本企業(含醫療財團法人)(名稱：\_\_\_\_\_)

與計畫主持人：\_\_\_\_\_合作，參與科技部研究計畫(計畫名稱：  
\_\_\_\_\_ )，對研究主題及產出有高度興趣，願意參與  
本研究計畫。

合作企業統一編號：

主要營業項目：

單位：

職稱：

電話：

E-mail：

合作企業技術聯絡人：\_\_\_\_\_ (簽章)

中華民國 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日